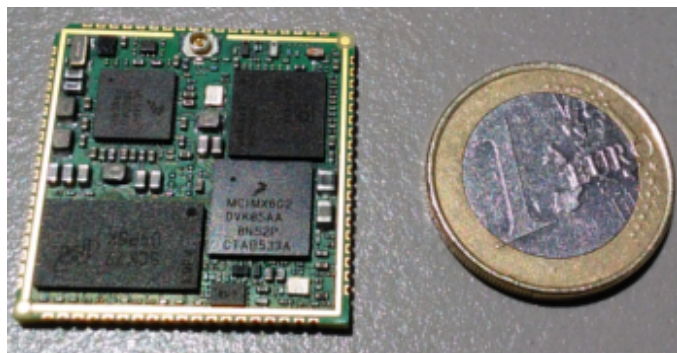


**CONSYSTEM S.r.l.**

**Your LOCAL PARTNER SPECIALIST**

*Press News Giugno 2016*



**Francobollo? No,  
i.MX6UL  
il più piccolo  
"System-on-Module"  
sul mercato!**

**DIGI presenta:  
ConnectCore i.MX6UL**

**DIGI**

La piattaforma, costruita sul nuovo processore NXP i.MX6UltraLite offre connettività wireless 802.11ac e Bluetooth 4.1 in un package sottile, poco più grande di un francobollo. L'innovativo footprint Digi SMTplus (patent pending) di soli 29x29x3,5mm attraverso le due opzioni di saldatura (full pinout > LGA e semplificato > Castellated Edge) offre una piattaforma scalabile che soddisfa un largo spettro di requisiti e consente di ottimizzare il progetto. Non ultimo il package a montaggio superficiale offre un'alta affidabilità in tutte le applicazioni caratterizzate da alte vibrazioni o shock da impatto.

#### **Caratteristiche principali della piattaforma SOM ConnectCore 6UL:**

- NXP i.MX 6UltraLite Cortex-A7 @ fino a 696 MHz, power management (PMIC), on-module Cortex-M0 microcontrollore Assist™ per applicazioni real-time di basso livello, watchdog, fino a 2 GB Flash SLC NAND, fino a 1 GB DDR3 modulo opzionale 802.11a/b/g/n/ac e Bluetooth 4.1 (Smart Ready) pre-certificato, dual Ethernet 10/100.
- Il Linux Board Support Package (BSP) fornisce un supporto software testato e regolarmente aggiornato.
- Temperatura di funzionamento a range industriale.
- Il development kit per ConnectCore 6UL sarà disponibile a settembre 2016 in due versioni: Starter kit e Jumpstart kit

**Per richiedere documentazione tecnica, disponibilità, campioni o ulteriori informazioni sui prodotti commercializzati, scrivete a [info@consystem.it](mailto:info@consystem.it)**

CONSYSTEM Srl - [www.consystem.it](http://www.consystem.it) - tel. 02-4241471- fax. 02-42291305

Se desidera cancellarsi dall'invio della Newsletter, inserisca il Suo indirizzo e-mail all'interno del messaggio che vorrà cortesemente inviare a [support@consystem.it](mailto:support@consystem.it)